

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 9 月 29 日(29.09.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/118157 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) C08K 5/101 (2006.01)
C08G 59/02 (2006.01) C08L 35/02 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08K 5/01 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/001533
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 16 日(16.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-070699 2010 年 3 月 25 日(25.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKE-LITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田部井 純一(TABEL, Jun-ichi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川

区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).

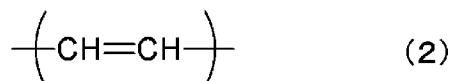
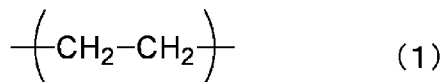
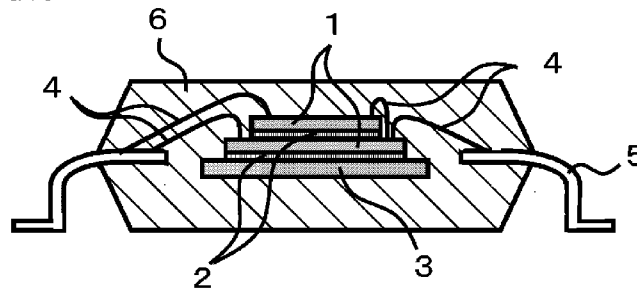
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田 7-9-2 五反田 T Gビル 9 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

[続葉有]

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEMICONDUCTOR ENCAPSULATION AND SEMICONDUCTOR DEVICE USING SAME

(54) 発明の名称: 半導体封止用エポキシ樹脂組成物およびこれを用いた半導体装置

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is an epoxy resin composition for semiconductor encapsulation, comprising (A) an epoxy resin, (B) a curing agent, (C) an inorganic filler, (D) a hydrocarbon compound having a structure of formula (1) and a structure of formula (2), and (E) a hydrocarbon compound having an ester group. Also disclosed is a semiconductor device containing a semiconductor element encapsulated with the epoxy resin composition for semiconductor encapsulation.

(57) 要約: 本発明によれば、(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 無機充填材、(D) 式(1)および式(2)の構造を有する炭化水素化合物、および(E) エステル基を有する炭化水素化合物を含む、半導体封止用エポキシ樹脂組成物、および該半導体封止用エポキシ樹脂組成物で封止された半導体素子を含む半導体装置が提供される。

WO 2011/118157 A1



(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))